

2026 第五届电子材料与器件大会

Conference on Electronic Materials and Devices

邀请函

尊敬的_____先生/女士：您好！

热忱欢迎您参加“2026 第五届全国电子材料与器件大会”。

会议旨在针对电子材料与器件领域及相关交叉学科的发展重点、热点、前沿问题展开讨论，分享最新成果，从研究与应用视角探讨我国电子材料与器件基础研究思路、面临的机遇、挑战与未来趋势，积极推进技术进步和工程化协同，把握科研和产业的发展趋势，推动产学研合作与跨越发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2026 年 10 月 30 日-11 月 1 日日 青岛市

二、会议官网：<https://chinamaterial.mike-x.com/mnrX3>

三、组织机构

主办单位：中国电子节能技术协会电子信息专业委员会、先进电子材料与器件专家委员会、电子信息专业委员会、NEMDC 电子材料与器件大会组委会

协办单位：甘肃省科学院传感技术研究所

承办单位：北京中科智材新材料科技发展中心、北京高科前沿科技发展中心

名誉主席：都有为、黄维

大会主席：陈广学、段纯刚、官建国、王向荣

三、会议内容（包括但不限于）

新型智能（智慧）电子材料与器件、半导体物理与器件、集成电路设计与制造、电子元器件关键材料与技术、电子材料与先进传感、生物电子器件与生物电子技术、电磁场与微波技术、其它等；

四、会议注册（食宿自理）

注册类型	10.10 日前	现场	付款方式
普通代表	2800	3000	1、户名：中国电子节能技术协会 账 户：0200004609014471534 开户行：工商银行北京公主坟支行 (请务必由对公账户汇出，并标注好“姓名+单位”，个人汇款不能开具单位发票)
会员代表	2600	2800	
学生代表	1600	1800	
企业代表	3000	3500	
线上参会	900/人		2、户名：北京中科智材新材料科技发展中心 账号：0200250109200790477 开户行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行 3、户名：北京高科前沿科技发展中心 账号：9550880223115100198 开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行

现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“青岛会邦国培会议服务有限公司”收取会议费并开具发票

